

연수 제안서

| | |
|--|----------------------|
| 연구 분야 | 차세대 컴퓨팅 하드웨어 설계 |
| 연구 과제명 | 글로벌탑거대 초거대 계산 반도체 |
| 연수 제안 업무 | 차세대 컴퓨팅 하드웨어 설계 및 분석 |
| <p>(연수 내용)</p> <p>- 연수기간 : 2024-09-01~2025-05-31</p> <p>인턴연구원 : 채용일로부터 최초 9개월 계약, 평가에 따라 계약 연장 가능(총 22개월)</p> <p>- 연수 내용 :</p> <ul style="list-style-type: none">- 파이썬 등을 활용한 통계처리 및 분석- 차세대 컴퓨팅 관련 알고리즘 개발 및 머신러닝/딥러닝 알고리즘 활용- SPICE 회로 분석 및 시뮬레이션- Verilog / System verilog 하드웨어 설계 | |
| 연수 책임자 : 홍석민 | |